



Recommended PCB Layout

- 要求: 1.表面镀金
- 2.吸塑盒包装, 100pcs/盘
- 3.用于PCB插板。

NO	DESCRIPTION描述	MATERIAL材质	SPECIFICATION规格	QTY数量	Limits	A(±)	B(±)	C(±)	D(±)	E(±)	F(±)	SIGNATURE	DATE作成日期	SH-Link® RF射频	深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd	SCALE 比例	WEIGHT 重量(g)	PERSPECTIVE 视角方法
6	Cover 后盖	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	0-6	0.03	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20	DRAWN BY 尚仕伟 2016.06.30 CHECKED BY APPROVED BY	SH-Link® RF射频 深圳市思翰铭科技有限公司 Shenzhen Sihanning Technology Co., Ltd SCALE 比例 WEIGHT 重量(g) PERSPECTIVE 视角方法	ITEM NO品号 SHM. 030. 048	PART DESCRIPTION品名 SMA-KWE-11			
5	Backseat 后座	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	6-18	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20								
4	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	18-30	0.08	0.10	0.15	0.20	0.25								
3	Insulator 绝缘体	PTFE 铁弗龙		1	30-50	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30								
2	Inner conductor 中心针	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	50-80	0.15	0.20	0.25	0.35	0.50								
1	Body 壳体	Brass 黄铜	GOLD PLATED 镀金	1	80-120	0.20	0.25	0.30	0.50	0.65	0.80							
					120-180	0.25	0.35	0.50	0.65	0.80	0.95							
					180-250	0.35	0.50	0.65	0.95	0.95	1.15							